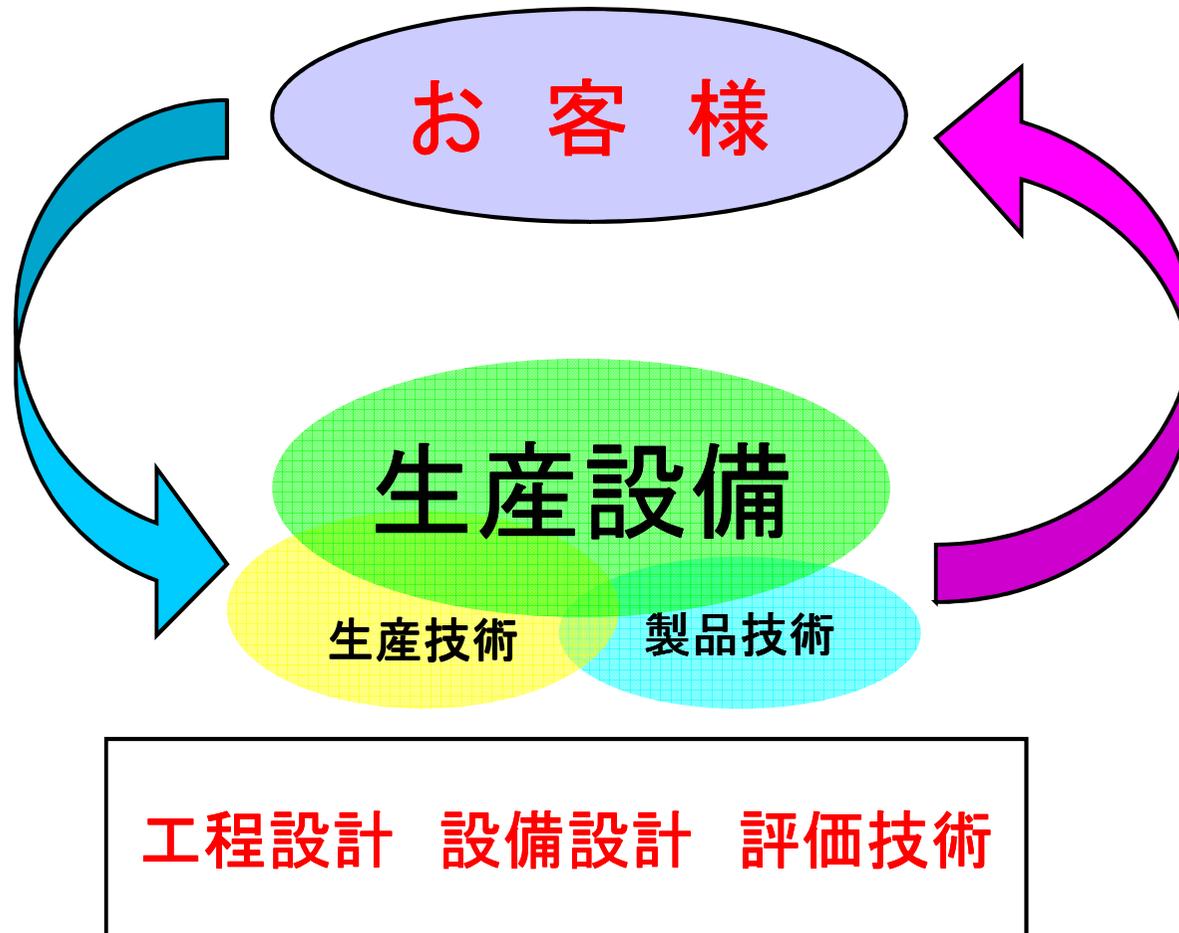


半導体関連設備開発 真空貼付装置のご紹介

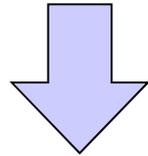
有限会社 都波岐精工

セミコンダクタ生産設備に関する トータルソリューション



具体的内容—セミコンダクタ設備開発

セミコンダクタ設備開発



真空テープ貼付装置

治工具の設計製作

手動組立・検査設備の開発設計・製作

半自動組立・検査設備の開発設計・製作

自動組立・検査設備の開発設計・製作

ウェハー用真空テープ貼付装置



TSM-300NT

仕様

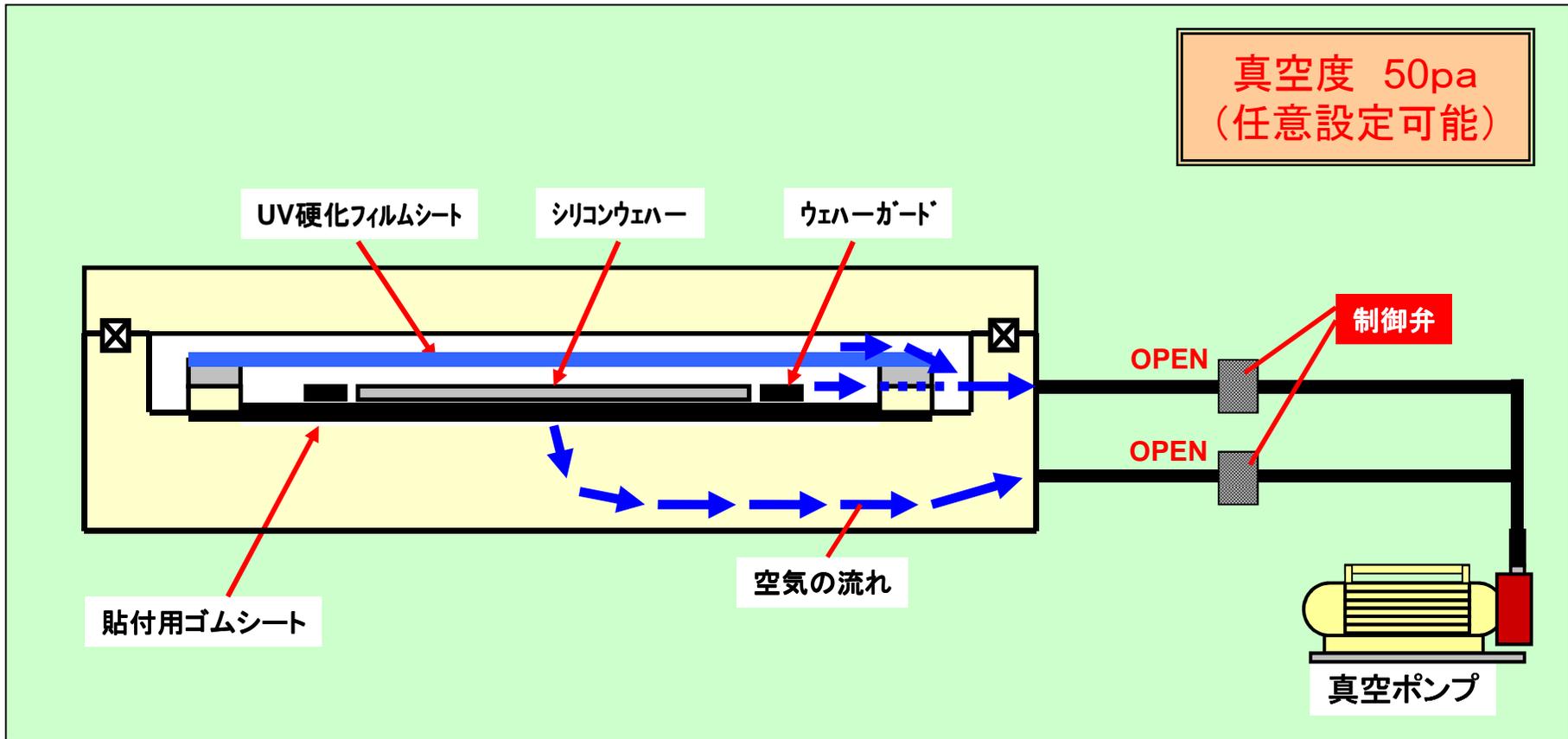
ウェハサイズ	Φ300mm(12インチ)以下対応
フィルム種類	UV硬化フィルムテープ
フレーム	標準ダイシングフレーム
サイズ	630 x 550 x 380
重量	70kg

ウェハ－用真空テープ貼付装置の特徴

- ウェハ－とフィルムの間に気泡が入らない
- 装置内を真空にした貼付方式
- スペースをとらないコンパクトな卓上型装置
- 熟練したオペレーターが不要なし
- UV硬化フィルムテープに対応
- 貼付ユニットを変更することで各種フィルムに対応

気泡が入らないテープ貼り付け

装置内真空引き機能

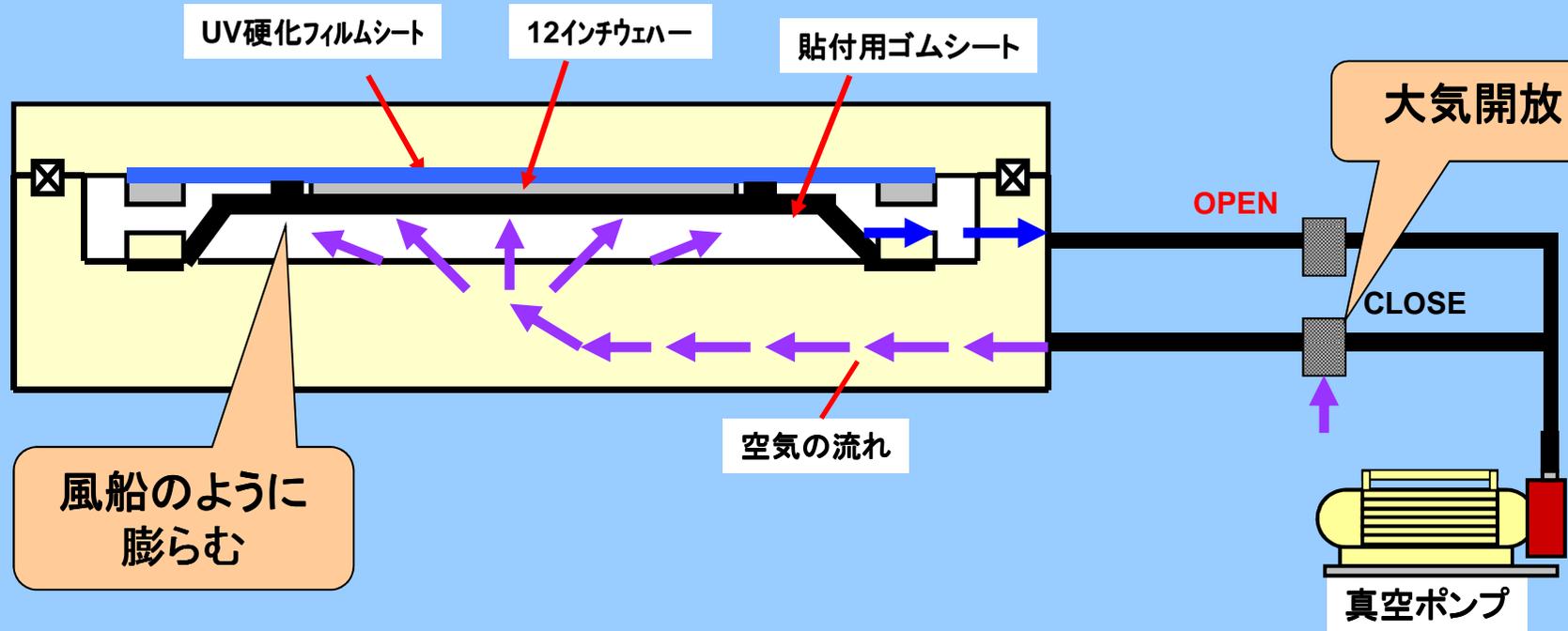


貼付機能

従来のローラー式貼り付けは
気泡が残る...

ウェハーテープ貼付

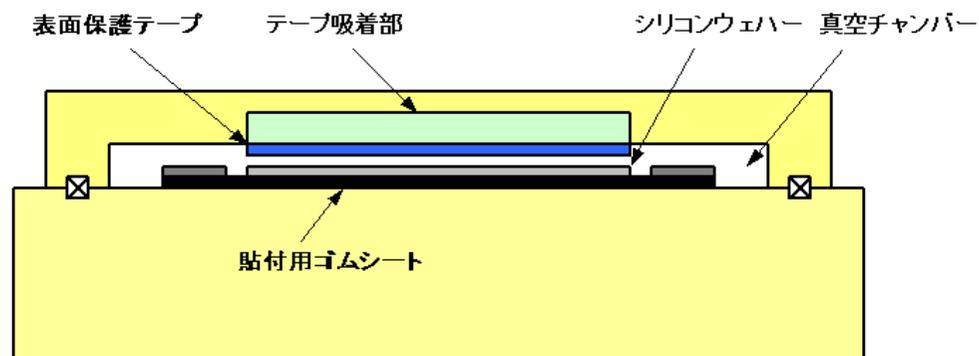
貼付圧力
(大気圧 0.1MPa)



表面保護テープ用真空貼付装置

装置の特徴

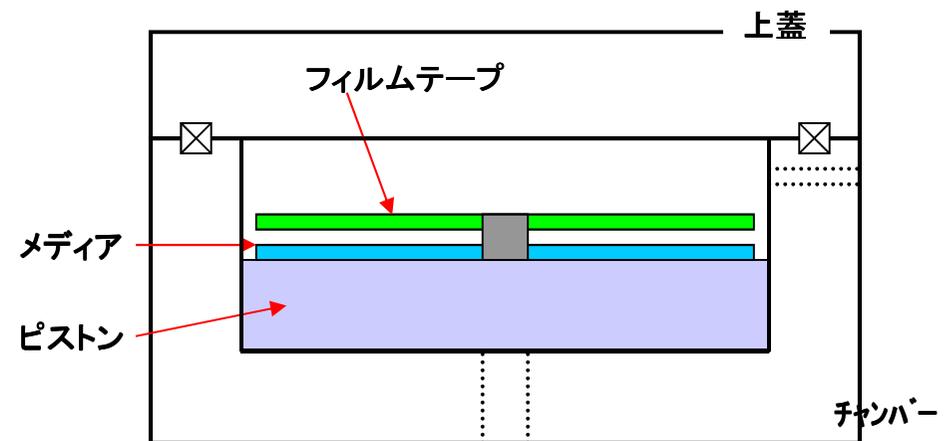
- 表面保護テープとウェハーの間に気泡なし
- 装置内を真空にした貼付方式
- 表面保護テープをテープ吸着部にて固定
- スペースをとらないコンパクトな卓上型装置
- 熟練したオペレーターが必要なし



ウェハ(基板)加圧式真空貼付装置

装置の特徴

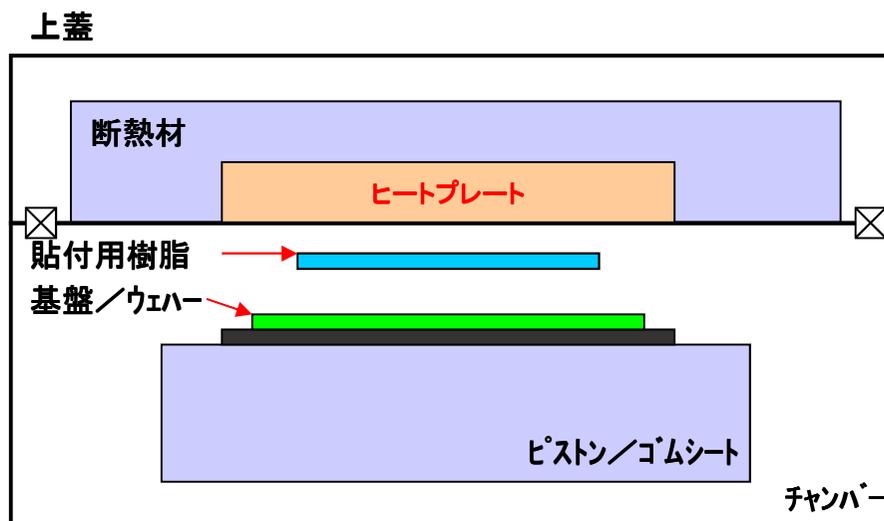
- 貼付
 - ①ウェハ(基板) + 各種フィルムテープの貼付
 - ②ウェハ(基板) + 基板の貼り合わせ(両面テープor接着剤等)
 - ③スタンプ+ウェハ(基板)の貼り合わせ(UV硬化樹脂等)
- 装置内を真空にした貼付方式 → 貼付圧力を0.5MPaまで設定可能
- スペースをとらないコンパクトな卓上型装置
- 熟練したオペレーターが必要なし



加熱方式真空貼付装置

装置の特徴

- 加熱を必要とする各種フィルム及び樹脂の貼付
- 装置内を真空にした貼付方式
- 加熱機能によるフィルム及び樹脂の貼付
- スペースをとらないコンパクトな卓上型装置
- 熟練したオペレーターが必要なし



お客様の要望に応じてカスタマイズ致します

例)

- 8インチ以下のウェハーサイズにも対応可能
- CD,DVD用テープ貼付及び貼り合わせの開発用試験装置
- UV硬化フィルムテープ以外にも対応可能
(伸びない素材・温度の必要とする素材)
- シリコンウェハー以外の凹凸や反りの大きな基板の貼付装置
- 小型液晶(12インチ以下)の貼り合わせ装置

その他関連商品



テープカット機



扉スライドタイプ



メディア向け貼付機